

2021 Moldex3D 全球模流達人賽

作品授權及刊登同意書

請於 2022 年 7 月 15 日(五)前，親簽後掃描 E-Mail 至 talentawards@moldex3d.com

本人(及本人團隊)_____ (以下簡稱本人)因參加科盛科技股份有限公司(以下簡稱科盛科技)主辦之「2021 Moldex3D 全球模流達人賽」(以下簡稱本活動)，同意以下本活動參賽辦法及規定，並授予科盛科技以下權利：

1. 本人擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。
2. 本人茲同意將所有繳交本活動的參賽作品(含文字、CAD模型、圖片及影片)等內容，永久無償授權科盛科技及其國內外關係企業及其授權之第三方，不限載體、用途、使用次數、地區、期間，包含但不限於散布、重製、發行、改作、翻譯、再授權、公開傳輸、公開展示、公開播送與公開發表之權，提供大眾進行檢索、瀏覽、下載、傳輸、列印及公開使用等。
3. 本同意書為專屬授權。本人保證並無侵害任何第三人之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權，且未曾參加其他CAE模流分析公司所舉辦的同性質競賽。作品如涉及著作權之侵權或其他不法行為，概由本人自行負責，科盛科技得取消得獎資格並追回獎金、獎狀及獎品。
4. 本人作品若有侵害他人權利或涉及違法，本人願負全部之賠償責任。若因此致科盛科技受有損害，本人願負賠償責任。
5. 本人已詳閱並同意遵守 [本次參賽之各項相關規定](#)。

此致

主辦單位：科盛科技股份有限公司

立同意書人(團隊代表)

_____ (簽名並蓋章)

_____ 身分證字號

_____ 年 月 日

主管/指導教授及單位簽章

_____ (簽名並蓋章)

_____ 身分證字號

_____ 年 月 日

職稱

統一編號	
地址	
日期	